

一般顧客用
管理基準

社内標準
(技術標準)

AMP
日本エー・エム・ピー株式会社

適用事業所
全社

114-1049-1

取付適用規格
Application Specification

ディプロメートDL(デュアル・リーフ)DIPソケット
Diplomate DL(Dual-Leaf) Dip Socket

1. はじめに

本規格は、プリント基板(PCボード)に対する手動/自動取付用のAMPディプロメートDL(デュアル・リーフ)DIPソケットの取付適用条件を規定している。

(注):別に規定がなければ、本規格に記載してある寸法は、すべてインチ建て設計をミリメートル換算したものである。表示のmm寸法は、インチ表示値を25.4倍した値に等しい。

Fig.1にはAMPディプロメートDL DIPソケット及びその各部の名称が示されている。この製品各部の名称を明示してある言葉は本規格全体を通して使用されている。

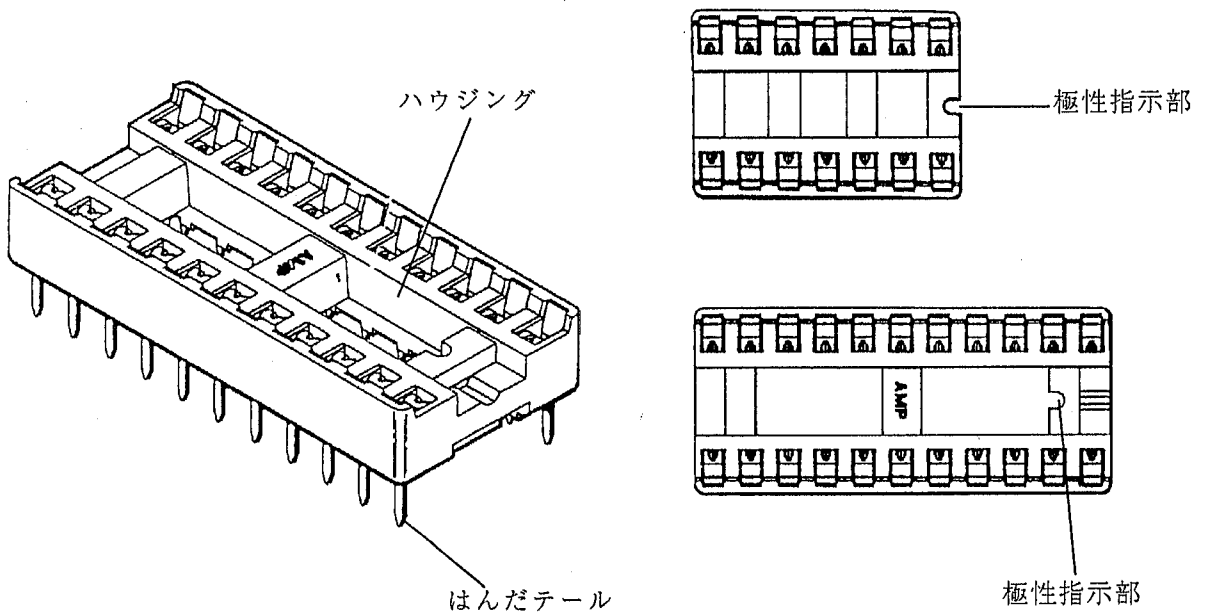


Fig.1 製品各部の名称

					作成: <i>[Signature]</i> 9.26.91	分類: 取付適用規格 Application Specification
					検閲:	コード: 114-1049-1
						改訂: 0
	EC 0990-1290-98	11.11.'98				
○	Released	<i>[Signature]</i>	MT 9.26.91	承認: 9.26.91	名称: ディプロメートDL(デュアル・リーフ)DIPソケット Diplomate DL(Dual-Leaf) Dip Socket	
改訂	改訂記録	作成	検閲	承認	年月日	
配布	年月日制定					4頁中1頁

2. 参照文書

2.1 製品規格

AMP 製品規格 108-1066 には、本製品の性能要件が規定されている。

2.2 顧客図面

AMP “顧客図面” は、本製品ラインに指定された型番ごとにある顧客図面に記載してある情報が本規格の情報と不一致があった場合は、顧客図面を優先して使用すること。

2.3 製品型番及びプロダクト・コード

製品型番号 641603 及びプロダクト・コード 1529 は、AMP デイプロメート DL DIP ソケットを代表するものである。上記番号を使用することにより、ユーザーが製品やツーリングに関する情報を得るのに役立つために確立された AMP サービス通信網を通してユーザーの照会を促進する。このような情報は、ユーザーの AMP 地域担当者 (フィールド・セールス・エンジニア、フィールド・アプリケーション・エンジニア等) によって得られる。あるいは、購入後は製品担当事業本部の営業を通して、この情報が得られる。

3. 必要条件

3.1 プリント基板レイアウト要件

プリント基板レイアウト要件は Fig. 2 に規定する通りとする。

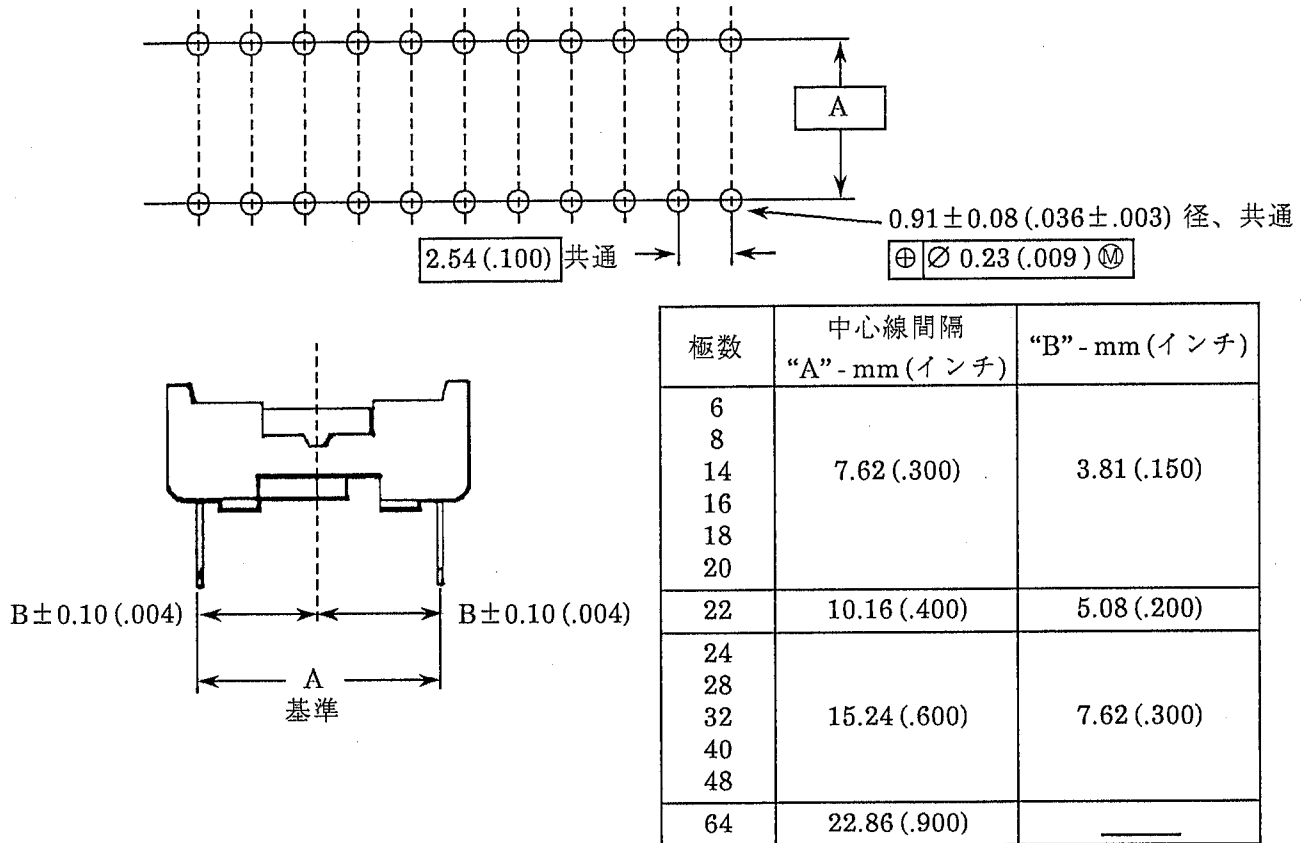


Fig. 2 プリント基板レイアウト・パターン

分類: 取付適用規格	標準の名称: デイプロメート DL (デュアル・リーフ) DIP ソケット	標準のコード: 114-1049-1	改訂	2 頁
			0	4 頁中

3.2 基板の厚さ

推奨最大基板厚さは 2.36 mm (.093) である。

3.3 取付け必要条件

はんだテールをプリント基板の穴に挿入する。そしてソケットが基板に対して平行であり、かつ基板上に静止していることを確認する。取扱い/はんだ付け中、ソケットを所定の位置に保持するために、はんだテールをクリンチした方がよい場合もある。。クリンチの方法は、その顧客の任意である。はんだテールの末端に(基板に対して垂直方向に)過剰な力を加えないようにすること、余分の力を加えると、コンタクトがハウジング内の正しい位置から外れることがある。

(注):リテンション・レグ方式のソケットは、それをその位置に保持するのにクリンチが必要である。

3.4 はんだ付け及びクリーニング

A. フラックスの選定

はんだ付け前に、はんだテールに中活性のロジン・ベースのフラックスを塗布すること。適正なフラックスの選定は、プリント基板の種類及び基板に取付けられている他の部品に基づいて行うこと。またフラックスは顧客のフローはんだ付けライン、製品及び安全の要件に合致しなければならない。

B. はんだ付け指導基準 (指針)

AMP コーポレート・ブリティン 52 は要求すれば入手でき、はんだ付けする場合のガイド(手引き)として使用できる。このブリティンには、フラックスの商品名やフラックス除去法と共に、種々のフラックスの種類や特性に関する情報が記載してある。また、このブリティンには、はんだ付け問題に関する情報のガイドとしてチェックリストが添付してある。

C. クリーニング

はんだ付け後、フラックス、残留物及び活性剤の除去は必ず行うこと。クリーニング手順は、そのはんだ付けラインで使用されるフラックスの種類による。

D. 乾燥

クリーニングされたアセンブリとプリント基板を乾燥させる時は、必ず 105 °C (銅合金コンタクト材の場合、80 °C) の温度をこえないこと。温度が高すぎると、ハウジング及び/またははめっきの劣化の原因となることがある。

4. 認定サポート

AMP ディプロメート DL DIP ソケットは、UL 及び CSA の認定を受けている。

分類: 取付適用規格	標準の名称: ディプロメート DL (デュアル・リーフ) DIP ソケット	標準のコード: 114-1049-1	改訂	3 頁
			0	4 頁中

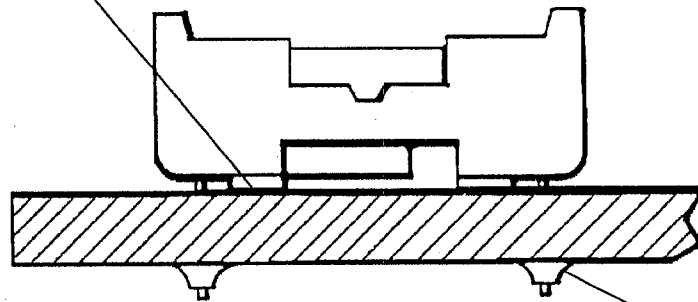
5. ツーリング

AMP ディプロメート DL DIP ソケットは手動または機械で取付けることができる。AMP 工具及び製品の両技術者は、ユーザー特別のセットアップや使用条件に適合する設備を設計する場合にユーザーを支援し、そして/またはその使用条件などに対して推奨を行うことができる。支援を得たい場合は、ユーザーの AMP 地域担当者に相談するか、製品担当事業本部の営業に連絡願いたい。

6. 視覚補助資料

Fig. 3 は、AMP ディプロメート DL DIP ソケットの代表的な取付適用条件を示している。この説明図は一般に生産作業者が適切にはんだ付けされた製品を保証するために点検すべき条件(状態)を描写している。目視で正しくない取付状態は、本規格主文に記載されている情報を用いて寸法検査を行うこと。

ハウジングをプリント基板上に突当てること



はんだに割れがないこと

Fig. 3 視覚補助資料

分類：
取付適用規格

標準の名称：
ディプロメート DL
(デュアル・リーフ) DIP ソケット

標準のコード：
114-1049-1

改訂	4 頁
0	4 頁中